

德州仪器 (TI): 在德克萨斯州理查森开创半导 体制造新时代

实现出色产能

- TI 的第 3 座也是规模最大的 300mm 晶圆制造厂 RFAB2 已进入**初始生产阶段**
- RFAB2 与 RFAB1 **相连**, 后者于 2010 年建成, 是全球第一座 300mm 模拟晶圆制造厂

打造先进制造工艺

- 清洁室面积共计**超过 58,000 平方米**
- 借助超过24公里的自动化高架轨道, 可在晶圆制造厂间无缝传送晶圆
- 到全面生产之际, RFAB1 与 RFAB2 每天共计可生产 **100 多万** 泛应用于电子产品领域的模拟芯片

建设可持续 发展的未来

- 致力于实现长期**负责任、可持续的制造**
- RFAB2 可满足 **LEED 金级认证标准**; RFAB1 是全球率先荣获 **LEED 金级认证** 的模拟半导体制造工厂

